

MPI TS2000-IFE Series | 200 mm オート・プローブシステム

ミリ波、ロードプル、SiPH および プロダクト・エンジニアリングに最適

マイクロボジショナおよびハイパワー・プローブ

- 4 RFおよび10 DC マイクロボジショナまで搭載可能
- 種々のマイクロボジショナを用意。ミリ波アプリケーション用のラージエリア型も用意
- 専用同軸、トライアキシャル、ケルビン・アームを用意

IceFreeEnvironment™

- オープン環境でマイナス温度でのプロービング
- マイクロボジショナとプローブカードを同時使用可能

プローブ・ブラテン

- 安定で高剛性
- RFマイクロボジショナ用の角形調整器
- 温度安定度を向上させる統合型エアークーリング
- 保守やサービスに容易なアクセス

RF校正

- RF校正用に2個の補助チャック
- 正確なRF校正のためにセラミック製チャックを使用
- 一定のコンタクトが保たれる様に1 μmの平坦度

Probe Hover Control™ (PHC)

- プローブをウエハにコンタクト/セパレートする際のマニュアル操作
- SENTIO® の中で1μm精度でフィードバック

アクティブ型防振機構

- 高性能防振機構プラットフォームを統合
- フットプリントを縮小
- 測定器用シェルブ(オプション)を利用することにより測定系のケーブル長を短くして、測定ダイナミックレンジ、方向性を向上

WaferWallet® MAX オプション

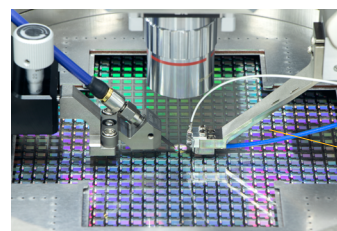
- 100、150または200 mm SEMI標準カセットを1個サポート
- 4色プログラマブル信号灯タワー
- プレアライナおよびカセットスキャナを含む
- オプションにより、上面または下面にウエハ IDリーダー
- 後付けが容易

THZ-選択オプション

- ミリ波、THz用システムに容易に変更可能
- MPI THZ選択により、TS200-THZ用に設計した画期的な周波数エクステンダー機構を組み込むことが可能。周波数エクステンダーを200 mmウエハ面上部で動作可能
- DUTとの距離を最小化することにより、測定の際の方向性と精度を改善

その他のオプション

- オファキシス・ウエハアライメント
- オファキシスPTPA
- 暗箱
- ShieldCap™



顕微鏡関連オプション

- 50 x 50x 140mm 移動可能プログラマブル顕微鏡用ブリッジマウント
- 種々の顕微鏡を用意。MPI iMAG® デジタル顕微鏡、MPI AMZ12、12倍光学ズーム顕微鏡
- 高分解能顕微鏡、FS70、PSM-1000

モジュラー型チャック

- 種々の常温、温度チャックを用意
- トライアキシャルまたは同軸接続
- 広い温度範囲、-60 °C ~ 300 °C
- チャーはシステムのフットプリント内に
- 後付け可能で、初期コストの削減

SENTIO® コントロールソフトウェア

- マルチタッチ操作で、簡単に直観的な操作により、オペレータのトレーニング時間を削減
- スクロール、ズーム、ムーブ等のスマートフォンと同等のコマンドで操作が可能で、短い時間で習得可能
- 使用中のアプリケーションとその他のアプリケーションの変更は簡単な指スワイプで可能
- MPI RF 校正用ソフトウェア、QAlibria® はSENTIO® に統合されており、操作は非常に簡単

温度コントロール

- 温度チャックはタッチスクリーン型ディスプレイより操作可能
- 設置個所はシステムの前面で、オペレータが素早く操作、フィードバック可能

統合されたハードウェア・コントロールパネル

- 迅速で安全なシステム・コントロールおよび測定操作が可能
- キーボードとマウスはソフトウェアのコントロールおよびWindows® ベース測定器のコントロールに使用

mDrive™ オプション

- チャック、顕微鏡、マイクロボジショナなど、既存のプログラム可能な全ステージを直感的に手動操作可能
- 選択したステージのX軸、Y軸微調整機能
- Z軸の安全機能を使用するには、追加の有効化操作が必要

Vertical Controlled Environment™ (VCE) オプション

- VCE™ により、プローブチップの側面を観測し、プローブカードのチップ・ドロップに関係なく、コンタクト位置の自動化が可能
- プローブカード、RF、DCプローブの安全使用の確保

シリコンフォトリソ用オプション

- ファイバーアライメント機器をシステムのフットプリント内に統合
- プローブ・ブラテンに優れた剛性を確保
- SENTIO® により統一した操作が可能